

層數 : 2
基材 : FR4
銅厚 : 1.57mm +/- 10 %
銅厚 : 1oz
表面 : ENIG (Au : 2-5u ")
阻焊 (銅) : 銅, LPI (銅)
阻焊 (銅) : 銅, 銅

銅厚

銅 : 銅 IPC-6012 銅 IMMING GOLD PLATED 銅.
銅 .050uM 3-6uM NICKEL 銅銅銅銅銅.

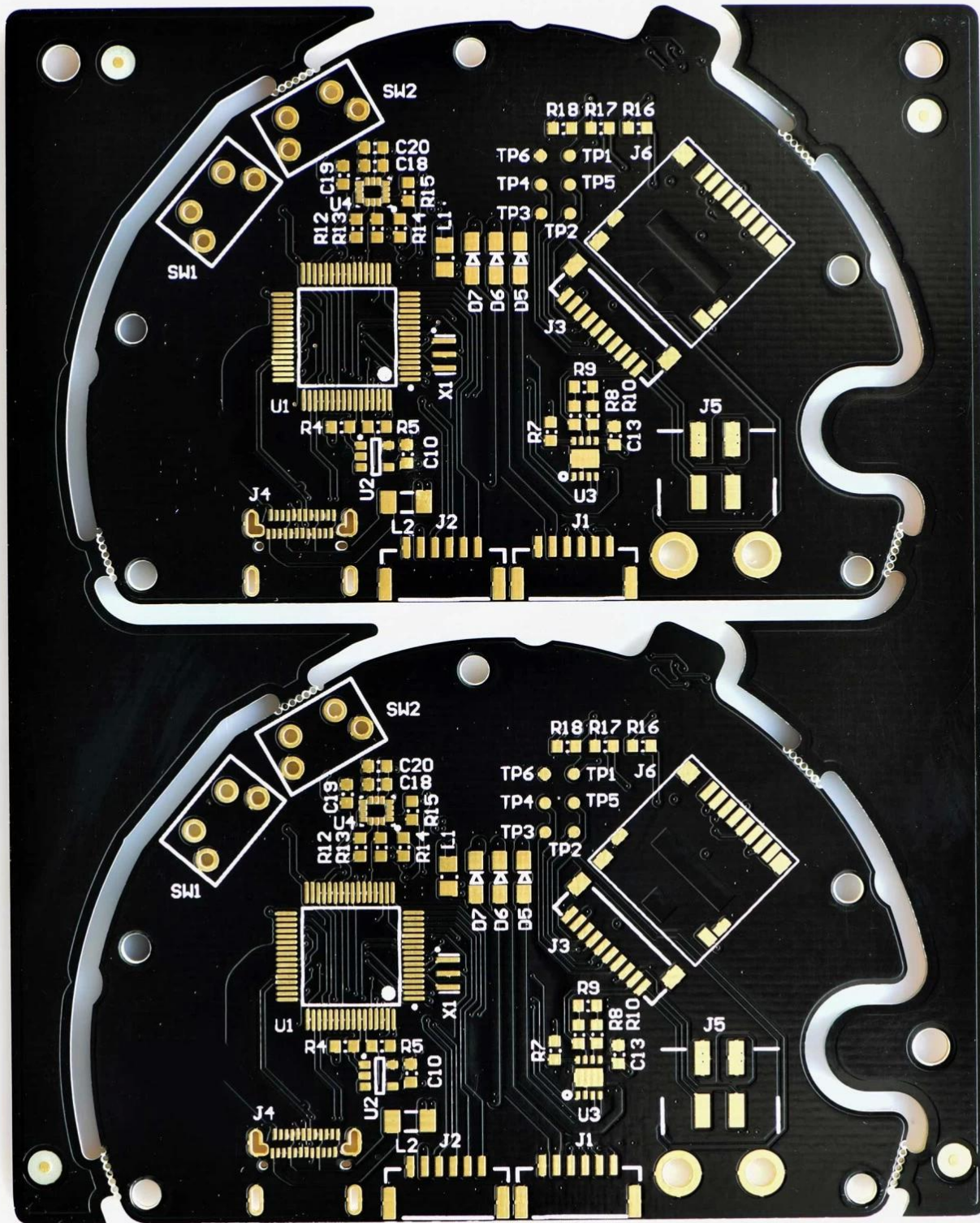
銅 銅銅 銅 銅 .025 AVG, .020 MIN .. 銅 銅銅銅 .500 銅 銅 銅 銅銅銅 銅銅 銅 銅 銅.

銅 銅 :

=====

*.GM4 : 銅 銅
*.TXT : NC 銅 銅

*.GTP : 銅 銅 銅
*.GTO : 銅 銅 銅
*.GTS : 銅 銅 銅
*.GTL : 銅 銅 銅
*.GBL : 銅 銅 銅
*.GBS : Bottom Soldermask
*.GBO : 銅 銅 銅
*.GBP : 銅 銅 銅



[pcb 阻抗, impedance PCB.](#)